

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2015年7月2日(02.07.2015)



(10) 国際公開番号
WO 2015/098342 A1

- (51) 国際特許分類:
H01L 21/66 (2006.01) **G06T 1/00** (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2014/080093
- (22) 国際出願日: 2014年11月13日(13.11.2014)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
61/920820 2013年12月26日(26.12.2013) US
- (71) 出願人: 浜松ホトニクス株式会社(HAMAMATSU PHOTONICS K.K.) [JP/JP]; 〒4358558 静岡県浜松市東区市野町1126番地の1 Shizuoka (JP).
- (72) 発明者: 堀田 和宏(HOTTA Kazuhiro); 〒4358558 静岡県浜松市東区市野町1126番地の1 浜松ホトニクス株式会社内 Shizuoka (JP).
- (74) 代理人: 長谷川 芳樹, 外(HASEGAWA Yoshiki et al.); 〒1000005 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号丸の内 MY PLAZA (明治安田生命ビル) 9階 創英国際特許法律事務所 Tokyo (JP).

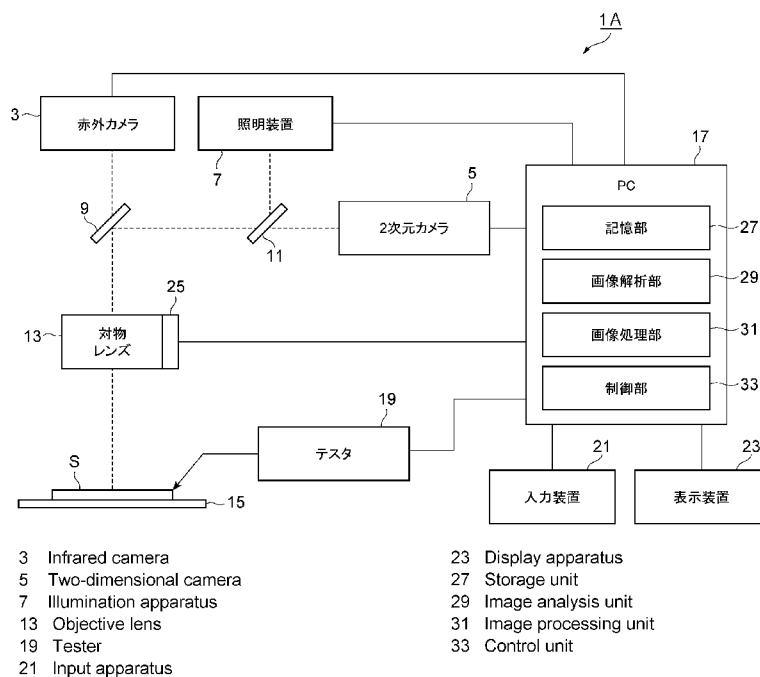
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第21条(3))

(54) Title: IMAGE PROCESSING METHOD, IMAGE PROCESSING APPARATUS, IMAGE PROCESSING PROGRAM, AND STORAGE MEDIUM IN WHICH IMAGE PROCESSING PROGRAM HAS BEEN STORED

(54) 発明の名称: 画像処理方法、画像処理装置、画像処理プログラム、及び画像処理プログラムを記憶した記憶媒体



(57) Abstract: An image processing method for an observation system (1A), said image processing method comprising: a first step for acquiring a measurement image (G_1) in which a semiconductor device (S) is the subject of measurement and further acquiring a first pattern image (G_2) which indicates a pattern of the semiconductor device (S) that corresponds to the measurement image (G_1); a second step for acquiring a second pattern image (G_3) which indicates the pattern of the semiconductor device (S); a third step for acquiring matching information on the basis of the first pattern image (G_2) and the second pattern image (G_3), said matching information indicating the relative relationship of the first pattern image (G_2) and the second pattern image (G_3); and a fourth step for acquiring a superimposed image (G_4) by superimposing the second pattern image (G_3) and the measurement image (G_1) on the basis of the matching information.

(57) 要約:

[続葉有]

WO 2015/098342 A1

観察システム 1 A における画像処理方法は、半導体デバイス S を対象に測定された測定画像 G_1 と、測定画像 G_1 に対応する半導体デバイス S のパターンを示す第 1 パターン画像 G_2 を取得する第 1 ステップと、半導体デバイス S のパターンを示す第 2 パターン画像 G_3 を取得する第 2 ステップと、第 1 パターン画像 G_2 と第 2 パターン画像 G_3 とに基づいて、第 1 パターン画像 G_2 と第 2 パターン画像 G_3 との相対関係を示すマッチング情報を取得する第 3 ステップと、マッチング情報を基に、第 2 パターン画像 G_3 と測定画像 G_1 とを重畳することによって重畳画像 G_4 を取得する第 4 ステップと、を備える。